

D7001: 4570 導電銀漿(單液型)

SYP-4570 填補列縫使用/加溫硬化 150°C 30 分

1. 黏度 16K±2K cps /by Brookfield DV-II+NO.SC4-14/10R(25±1°C)
2. 外觀:銀色
3. 固含量 70±2%
4. 基材：ITO/PET、ITO/glass,glass,PET,polyimide,polyester,polycarbonate
5. 主要用途/特長：EMI & electric circuitry/Flexible printed circuits Thermoplastic type
6. 印刷條件：一般 200~325mesh 不銹鋼網。
7. 張力：30±5(N/CM)²,乳膠厚度 12-25um
8. 熟化溫度：140±20°C速連續 30 分鐘加溫硬化。
9. 阻抗：≤10.0 ×10⁻⁵Ω-cm,溫度 25±1°C。
10. 附着性：不可脫落。(3M 百格測試 OK)
11. 可繞性：變化率：≤300%(測試條件：180 度,來回 5 次,(PET 適用)
12. 硬度：≥2H(鉛筆)
13. 耐去漬油溶劑
14. 洗版劑：酮或酯類
15. 保存：5°C~30°C常溫 6 個月。

最小包裝量 1Kg/EA

大瑞化學工業有限公司

40764 台中市西屯區臺灣大道 4 段 786 巷 48-2 號

TEL: 04-24631097 FAX: 04-24632633